

Applied Materials und EVG kooperieren – September 9, 2021



Dr. Thomas Uhrmann, Business Development Director von EVG: »Über die Zusammenarbeit mit Applied Materials erhalten wir ein tiefes Verständnis über die gesamte Prozesskette, was es uns erlaubt, unser Wafer-to-Wafer-Hybrid-Bonding optimieren zu können.«

## **Gemeinsam wollen Applied Materials und die EV Group (EVG) das Wafer-to-Wafer-Bonding optimieren, ein wesentlicher Prozess für die 3D-Integration von ICs.**

»Zunehmend treibt die 3D-Integration und die Entwicklung neuer Materialien die Fortschritte in der Halbleitertechnik. Deshalb steigt der Bedarf an Wafer-to-Wafer-Hybrid-Bonding. Diesen kritischen Prozess zu optimieren, erfordert ein tiefes Verständnis der Probleme über die gesamte Prozesskette«, sagt Dr. Thomas Uhrmann, Business Development Director von [EVG](#). »Über Kooperationen wie mit Applied Materials können wir wichtige Daten austauschen, die die Maschinen verschiedener Hersteller in den jeweiligen Prozessschritten sammeln. Das hilft uns, unsere Prozesse zu optimieren und die Probleme unserer Kunden besser zu lösen.«

Applied Material bringt dazu sein Know-how auf den Sektoren Deposition, Planarisation, Implant, Metrologie und Inspektion ein. Die Stärken von EVG liegen im Wafer-Bonding, in der Wafer-Vorbehandlung, der Aktivierung, im Alignment und in der Bond-Overlay-Metrology.

»Über die Zusammenarbeit mit Partnern wie EVG und Besi kann Applied Materials das Know-how und Expertenwissen an seine Kunden weitergeben, das sie brauchen, um die Entwicklung und die Einführung von hybriden Bonding-Technologien – sowohl Die-to-Wafer als auch Wafer-to-Wafer – zu beschleunigen«, sagt Vincent DiCaprio, Managing Director of Business Development for Advanced Packaging von Applied Materials.

<https://www.elektroniknet.de/halbleiter/applied-materials-und-evg-kooperieren.189596.html>